

描述

聚酰亚胺是一种薄的半透明材料，具有出色的介电强度。它也耐大多数化学药品，酸和碱。

温度范围低至-271°（液氮）至350°C。如果需要，我们可以集成热敏电阻，传感器和IC之类的组件。

技术指标

最高最低温度元件温度 20°	+200°((392°F)
时的介电强度	-271°(-456°F)
按照 ASTM KV / mm	205
100° (W / m·K) 时的导热系数	0,12
吸水率符合 ASTM D-570- 63 标准 (在 23°C 下浸泡 24 小时)	2,8%
符合 IEC 335-1 的防水标准。15-16	3,5
介电常数 25° (, 50 Hz 最小弯曲半径)	1 毫米 610
最高元件宽度功率密度	毫米
电阻公差	1,3 W / cm ² (取决于应用)
额定电压	标准±标称值的 10%可选, 最高 20 / o
	最高 1000VAC / VDC 单相或三相。



Etched elements

聚酰亚胺膜电热片的优点

- o 高低温范围
- o 优异的介电强度
- o 良好的耐化学性
- o 集成组件可能

市场

- o 要求低除气性能的军事/航空航天
- o 需要高压灭菌器清洁或消毒的医疗诊断仪器
- o 摄影器材
- o 液晶显示器
- o 实验室研究

圣柏林电热，您在散热解决方案方面的合作伙伴！